证券代码: 300400 证券简称: 劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2023-004

√特定对象调研 □分析师会议 □媒体系		
	— 采访	
投资者关系活动	舌动	
√现场参观 □其他(电话会议)		
华金证券研究所 王臣复 广发证券 汪燕 中信证券	李冬琪	
	岸 谭丽妮	
参与单位名称及 前海融睿投资 徐佳 汇恒富资产 杨高 青朴资本 人员姓名	严朴	
黄石国资基金 冯志强 长润君和资产 杨小龙 龚显朋	生 王爱兵	
前海万利私募基金 谢钦鸿 中垠资本 唐邦栋		
时间 2023年7月11日(星期二)下午14:30至16:30	2023年7月11日(星期二)下午14:30至16:30	
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司劲拓光电产业园 15 楼会地点	议室、	
部分生产车间		
上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 陈文娟女士		
员姓名		
一、接待人员介绍公司基本情况		
(一) 公司简介		
劲拓股份(300400)是一家深圳证券交易所创业板上市会	公司,成立于	
2004年,2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园,均位:	2004年,2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园,均位于深圳市宝安	
区,目前同步使用中,建筑面积合计约10万平方米,欢迎广	区,目前同步使用中,建筑面积合计约10万平方米,欢迎广大投资者到公	
司实地参观。		
(二)公司从事的主要业务		
公司主营专用设备业务,具体可分为三类:电子装联设备 投资者关系活动	公司主营专用设备业务,具体可分为三类: 电子装联设备(电子热工设	
备及配套设备)、半导体专用设备、光电显示设备。	备及配套设备)、半导体专用设备、光电显示设备。	
主要内容介绍 1、公司设立以来持续深耕电子热工相关领域,被行业协会	1、公司设立以来持续深耕电子热工相关领域,被行业协会授予"电子热	
工领域龙头企业"称号,回流焊设备获国家工信部"制造业单巧	工领域龙头企业"称号,回流焊设备获国家工信部"制造业单项冠军产品"认	
证、全球市场占有率领先。这块业务是公司领先优势业务,也是	证、全球市场占有率领先。这块业务是公司领先优势业务, 也是公司的基本	
盘。		
2 八司防丘地工 2017 年左巳火山且三地名 立日家政治	至外技术封锁,	
2、公司随后约于 2017 年布局光电显示业务,产品突破海	7/13/1-21/0/	
应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、只		

模组厂的认可并实现长期深度合作。

3、公司自 2021 年起布局半导体专用设备业务,目前系公司重点发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破,研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等多款半导体热工设备、硅片制造设备,并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。2022 年为半导体专用设备规模化销售元年,相关设备产品累计交付服务客户超过 20 家,获得客户的认可、验收及复购。公司高度重视半导体专用设备业务的发展,不仅制定了明确的业绩考核要求,在各类资源投入方面也有所侧重。

(三)公司的核心竞争力

公司的核心竞争力主要体现在产品力方面。电子装联业务系公司的优势业务和基本盘,技术实力、产品质量、市场份额和品牌知名度得到广泛认可,一直走在行业前列。半导体专用设备业务方面,公司研发生产了多款国产空白的半导体热工设备、硅片制造设备并逐渐打开市场,获得半导体行业客户的认可和复购,奠定了半导体专用设备业务长足发展的基础。公司光电显示设备作为突破技术封锁的国产替代产品销售给全球显示巨头企业,获得下游核心客户的认可并长期深度合作。

投资者关系活动 主要内容介绍

客户方面,公司拥有一批稳定优质的客户群体,累计服务客户 4,000 余家,其中半导体专用设备交付客户 20 余家;凭借多年来优质的产品和服务,在业内积累了良好的口碑和声誉,体现了公司的软实力。

研发方面,公司多年来坚持自主研发创新,多款设备打破国外技术垄断,在热工学温度控制、OLED 屏幕贴合等方面形成了具有自主知识产权的核心技术;建立了较完善的研发体系,能够不断复制成功经验和领先优势,技术延展和突破能力强。

此外,公司在高效的营销服务体系、强大的生产交付能力等方面具有 领先优势,而稳健良好的财务基础、充裕的现金流为公司应对外部环境变 化、持续开展研发攻关提供了有力保障。

(四)公司的经营情况

2022 年度,公司实现营业总收入 79,117.78 万元,主要受宏观环境不利 因素影响有所波动;实现归属于上市公司股东的净利润 8,910.33 万元,较 上年同期上升 11.41%;经营性现金流质量良好,实现经营性现金流量净额 12,906.49 万元。

2023 年第一季度,公司实现营业收入 14,227.26 万元,较上年同期上升 9.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 264.99 万元,主要受到研发费用 增加等因素影响,较上年同期有所下降。往年的分季度经营成果数据显示,

一季度往往是相对淡季,公司将在半年度报告中披露 2023 年上半年经营业绩,敬请投资者关注后续披露信息。

二、问答交流

1、公司在电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备上有哪些客户?

回复:公司电子装联设备的技术实力、产品质量得到电子行业下游大型品牌企业及厂商认可,公司与华为系、比亚迪系、富士康系企业客户长期保持合作关系;公司自主研发生产多款进口替代的光电显示设备,向京东方等国产面板厂商和大型模组厂供货;公司的半导体专用设备已累计交付20余家半导体行业客户,产品得到验收及复购,正在陆续接洽意向客户和潜在客户并取得积极进展。

2、公司开展半导体芯片封装业务的原因是什么?

回复:公司经前期市场调查和商业机会研判,依托于国内领先的热工设备领域的温度控制核心技术,实现技术应用领域和产品线延展,从而顺利切入了半导体专用设备业务领域,快速开发定型了多款半导体专用设备产品。

投资者关系活动 主要内容介绍

公司看好半导体封测行业的发展前景,继 2022 年首次实现半导体专用 设备业务规模化销售后,未来将继续把握相关设备进口替代机遇,着力推 进半导体专用设备业务高质量发展。

3、公司针对未来营业收入有制定业绩目标吗?

回复:公司在第二期员工持股计划及 2022 年限制性股票激励计划方案中,针对各年营业收入制定了增速考核目标;其中,半导体专用设备业务营业收入增速考核目标为: (1)以 2022 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2023 年半导体专用设备业务营业收入增长率不低于 60%,且 2023 年半导体专用设备业务营业收入值不低于 5,000.00 万元; (2)以 2022 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2024 年半导体专用设备业务营业收入值不低于7,500.00 万元; (3)以 2022 年半导体专用设备业务营业收入值不低于7,500.00 万元; (3)以 2022 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2025 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2025 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2025 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2025 年半导体专用设备业务营业收入值不低于7,500.00 万元; (3)以 2022 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2025 年半导体专用设备业务营业收入值为基准,2025 年半导体专用设备业务营业收入值不低于10,000.00 万元。

4、公司海外市场订单情况如何?

回复:公司产品一直有部分出口,2022 年总体出口销售规模占比为

6.71%。目前全球相关产业链分工调整带来部分海外市场机遇,公司上半年已陆续接到有关订单,公司将多措并举地增强在海外市场的竞争力、为境外客户提供良好的服务体验。

5、公司介绍的两个工业园,均是公司自有的吗?

回复:公司拥有两个产业园区,一个位于宝安区鹤州工业园区,一个位于宝安区石岩街道,面积共 10 万平方米。两个工业园均为使用自有的土地自建的产业园,产权清晰、为公司所有。两个工业园目前总体利用率未达到 100%,后续可用于满足扩产需求。

6、公司控股股东、实际控制人吴限先生拟委托公司表决权事项预计什么时候完成?吴限先生现在还在公司担任职务吗?

回复: (1)公司控股股东、实际控制人吴限先生筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"东阳经鸿伟畅")委托其所持公司 27.9%表决权,该事项可能导致公司控制权变更。

吴限先生拟委托其表决权事项目前处于意向阶段,公司于 2023 年 1 月 30 日披露了双方《表决权委托意向协议》有关内容,同时结合双方后续签署的补充协议,该《表决权委托意向协议》有效期至以下三个时点中较早之日止:①委托方、受托方签署《表决权委托协议》且协议生效之日;②委托方、受托方签署《表决权委托意向协议之终止协议》且协议生效之日;③2023 年 12 月 31 日。

投资者关系活动 主要内容介绍

公司本次控制权变更相关事项尚存在不确定性,针对该事项进展情况,公司将在获知有关进展后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,谨慎决策、注意投资风险。

(2) 吴限先生是公司的创始人,目前在公司任职,不担任公司治理层、 高级管理职务。

7、公司半导体专用设备主要有哪些? 竞争对手主要有哪些,公司有哪些竞争优势?

回复:公司半导体专用设备包括半导体热工设备和半导体硅片制造设备,半导体热工设备是用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备,半导体硅片制造设备则用于半导体硅片生产过程。公司半导体专用设备目前主要有半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、半导体硅片制造设备等,目前主要对标美国、德国等国产品和技术较为成熟的品牌设备厂商。

公司半导体专用设备在技术和性能方面对标国外厂商,能够满足客户

的短周期交付需求,同时具备价格优势、快速响应的售后服务优势。

8、公司半导体专用设备目前有哪些客户?对于目前有关产业链固定资产投资景气程度怎么看?

回复:公司半导体专用设备目前面向国内大型封测厂商、硅片制造企业,累计服务客户逾20家,其中包含优质的上市公司、大型企业。

公司长期看好半导体产业链发展前景,当前意向客户和潜在客户接治 进展良好。公司自 2022 年首度实现半导体专用设备的规模化销售,未来将 积极把握市场增量和存量机遇,加快相关应用领域的进口替代步伐。

9、公司回流焊是制造业单项冠军,这块的市场空间、竞争格局和公司 发展规划分别如何?

回复:公司系国内电子热工领域的龙头企业,市场占有率领先,竞争对手主要为美国、德国的品牌企业。公司会积极把握全球市场的存量更新和新增需求机会,力争继续提高产品市场占有率。2023年伴随着电子制造产业链全球分工调整,公司也积极推动品牌更好地走向国际,加强对海外市场布局、拓展订单来源。

投资者关系活动 主要内容介绍

10、公司光电显示设备主要有哪些产品?公司光电显示设备业绩有一 定的波动,主要原因是什么?

回复:公司光电显示设备用于光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组的生产制造过程,按功能分类主要有 3D 贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等,相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域。

光电显示设备近年来主要受到下游需求波动和同行业竞争加剧的影响,订单有一些波动;加之产品有一定的验收周期,以及客户对同一批产品集中验收等,致使不同会计期间收入可能有波动。总体上光电显示业务的下游市场空间广阔、需求总量较大,公司具备优质的客户资源,未来将发挥差异化竞争优势、争取更大的市场份额。

11、公司 2023 年的研发方向是怎样的?

回复:公司 2022 年度研发投入金额为 4,417.22 万元,研发人员占公司总人数的 16.51%。公司始终重视研发创新,2023 年将继续攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体设备,推动半导体专用设备产品拓展、性能提升、研发成果转化;同时优化和提升电子装联设备、

	光电显示设备性能,提高产品技术壁垒。
12、公司及子公司有开展一些投资业务吗?	
	回复:公司子公司深圳市劲彤投资有限公司系公司实施对外投资的平
	台,目前已投资控股了主营半导体专用设备业务的深圳市思立康技术有限
	公司、深圳至元精密设备有限公司,参投了深圳市中经彤智企业管理有限
	公司等。公司设立劲彤投资有利于集中进行对外投资的专业决策和投后管
	理,其不涉及高风险投资或二级市场股票投资。
	三、现场参观
	现场交流结束后,调研人员参观了公司部分电子装联设备、半导体专
	用设备及光电显示设备生产车间。
附件清单(如有)	无
日期	2023年7月11日